

2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告

中国市场报告网

360baogao.com

报告介绍

报告名称：2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告

报告编号：2356270

报告价格：纸质版：9200元 电子版：9500元 纸质+电子版：9800元

优惠价格：8600元

咨询电话：400 612 8668、010-66181099、010-66182099 传真：010-66183099

咨询邮箱：kf@360baogao.com

在线阅读：<http://www.360Baogao.com/0/27/PCBHangYeQianJingFenXi.html>

温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本报告，请向客服咨询。

报告目录：

据中国市场报告网发布的2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告显示，在**年全球市场份额分布情况来看，中国占全球PCB行业总产值比例超50%；亚洲其他地区（主要是韩国、中国台湾和东南亚）占比也达到32.6%；美洲、欧洲、日本比例分别为4.7%、3.3%、8.9%。

2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告

2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告是对PCB行业进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告如实地反映了PCB行业客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。

2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告揭示了PCB市场潜在需求与机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一章 PCB行业概述

1.1 PCB的介绍

1.1.1 PCB的定义

1.1.2 PCB的分类

1.1.3 PCB的特点

1.2 PCB的产业链

1.2.1 PCB产业链的构成

1.2.2 产业链中的产品介绍

1.3 PCB行业标准

1.3.1 国际标准

1.3.2 国内标准

1.4 PCB特点

- 1.4.1 电路板属订单型生产形态
- 1.4.2 电路板的制造流程长且复杂
- 1.4.3 电路板属资本密集型行业
- 1.4.4 电路板的议价能力相对较弱

第二章 全球PCB行业发展分析

2.1 2014-2018年全球PCB市场情况分析

- 2.1.1 2014-2018年全球PCB行业格局分析
- 2.1.2 2014-2018年全球PCB产品结构分析
- 2.1.3 2018年全球PCB行业发展分析

2.2 2014-2018年主要国家地区PCB市场分析

- 2.2.1 2014-2018年日本PCB市场分析
- 2.2.2 2014-2018年韩国PCB市场分析
- 2.2.3 2014-2018年北美PCB市场分析
- 2.2.4 2014-2018年台湾PCB市场分析
 - 1、台湾PCB市场总体分析
 - 2、台湾PCB之市场分析
 - 3、台湾PCB之群聚与结构
 - 4、台湾PCB之竞争力分析
- 2.2.5 2014-2018年欧洲PCB市场分析

第三章 中国PCB行业发展分析

3.1 中国PCB行业发展概述

- 3.1.1 中国PCB行业发展简史
- 3.1.2 中国PCB行业发展特点
- 3.1.3 中国PCB行业发展总体分析
- 3.1.4 中国PCB工业发展情况分析

3.2 中国PCB行业发展面临的问题

- 3.2.1 美国重塑制造业影响中国制造业
- 3.2.2 PCB设备仪器企业发展不够快
- 3.2.3 PCB原辅料企业还很弱小
- 3.2.4 从事PCB环保的企业缺乏特色

3.3 2018年中国PCB行业市场分析

- 3.3.1 2018年中国PCB行业发展现状
- 3.3.2 2018年中国PCB市场规模分析
- 3.3.3 2018年中国PCB产品结构分析

- 3.4 2018年中国PCB产品供需分析
 - 3.4.1 2018年PCB产品需求分析
 - 3.4.2 2018年HDI板产品需求分析
 - 3.4.3 2018年手机PCB产品需求分析
 - 3.4.4 2018年终端产品对PCB需求分析
- 3.5 2018年中国PCB设备发展分析
 - 3.5.1 2018年PCB制造设备市场分析
 - 3.5.2 2018年PCB高端设备存在的问题
 - 3.5.3 中国PCB专用设备制造发展趋势

第四章 深圳PCB发展分析

- 4.1 深圳PCB回顾
 - 4.1.1 深圳PCB总体情况
 - 4.1.2 深圳PCB发展分析
- 4.2 深圳PCB未来发展
 - 2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告
 - 4.2.1 未来深圳PCB市场分析
 - 4.2.2 未来深圳PCB格局
- 4.3 深圳PCB发展趋势
 - 4.3.1 迈向高端制造
 - 4.3.2 发力服务
- 4.4 深圳PCB启示与总结
 - 4.4.1 制造业完善链的启示
 - 4.4.2 深圳PCB总结

第五章 PCB上游原材料市场分析

- 5.1 铜箔
 - 5.1.1 铜箔的相关概述
 - 5.1.2 铜箔的全球供应状况
 - 5.1.3 铜箔在柔性PCB中的应用
 - 5.1.4 电解铜箔的发展分析
- 5.2 环氧树脂
 - 5.2.1 环氧树脂的相关概述
 - 5.2.2 环氧树脂的应用领域
 - 5.2.3 中国环氧树脂的市场前景
 - 5.2.4 2018年环氧树脂市场走势分析
 - 5.2.5 PCB用环氧树脂发展趋势
- 5.3 玻璃纤维

5.3.1 玻璃纤维的相关概述

玻纤布也是覆铜板的原材料之一，由玻纤纱纺织而成，约占覆铜板成本的40%（厚板）和25%（薄板）。玻纤纱由硅砂等原料在窑中煅烧成液态，通过极细小的合金喷嘴拉成极细玻纤，再将几百根玻纤缠绞成玻纤纱。玻纤布的初始建设投资巨大，且停车成本较大，需不间断生产。因此，玻纤布的价格受供需关系影响最大，在市场需求剧烈变动的情况下，玻纤布的市场价格变动较大。玻纤布规格比较单一和稳定。目前中国大陆及台湾地区的玻纤布产能已占到全球的70%左右。

玻璃纤维及制品制造，指以叶腊石、硼钙石等为原料经筛选、清洗、研磨、高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺加工成性能优异的无机非金属材料的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），中国把玻璃纤维及制品制造行业归入非金属矿物制品业（国家统计局代码C30）中的玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306），其统计4级代码为C3061。

玻璃纤维是一种由熔融玻璃制成、性能优异的功能材料。按标准级规定，可以分为E级、S级、C级、A级、D级、等几类；根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱、中碱和高碱玻璃纤维；按照单丝直径的大小可分为粗纱、细纱和电子纱等三大系列。其中，粗纱常与树脂复合后制成玻纤增强塑料（玻璃钢），纺织细纱可制成玻纤纺织制品，用电子纱织造而成的玻纤布主要用于制造印刷电路板的原材料覆铜板等。

从产品的用途上看，玻纤主要有以下几类产品：1）热固性增强基材，如可用于满足风电用的玻纤制品；2）热塑性增强基材：如短切纤维、混合纱、长纤维增强材料（LFT）、玻纤毡增强片材；3）沥青用玻纤增强材料；4）玻纤产业织物。其中，增强材料占比约70%-75%；而纺织材料约占25%-35%。

玻璃纤维制品分类

类别

特性

用途

无碱玻纤（E-玻璃）

良好的电气绝缘性及机械性能，耐高温，不耐酸和强碱

玻璃钢增强材料、管道、风电叶片、汽车车体、贮罐、渔船、游艇、模具、土工格栅

中碱玻纤（C-玻璃）

耐化学性特别是耐酸性优良，电气性能差，价格低廉

耐腐蚀，广泛应用于石油、化工领域管道储罐及建筑、工业设备、体育设施、酸性过滤布、窗纱基材等

高碱玻纤（A-玻璃）

碱金属含量14%-17%，熔制和成形温度比E玻纤低。耐酸性好，机械强度较差，耐水性差。

耐酸性的蓄电池隔板、电镀槽、硫酸厂酸雾过滤

耐碱玻纤（AR）

组成中含有氧化锆，能耐碱性物质长期侵蚀

增强水泥

高性能玻纤分类

类别

细分类别

分类

特性

用途

高性能玻纤

高强高模玻纤

S-玻璃、S-2、Hiper-tex、Vipro、TM-glass、GMG

高模量玻纤，弹性及强度

中国のPCB産業発展状況の調査と市場の見通しは2019-2025年

国防军工、航空航天、风电叶片基材、压力容器及高压管道

耐腐蚀玻纤

ECR、Advantex、E6、ECT

无氟无硼，防止化学物质腐蚀，耐酸性与耐水性好

烟气脱硫、化工机海洋工程用容器及管道

低介电玻纤

D-玻璃、NE、L-glass

其B₂O₃含量甚高（20%-26%），故其介电常数和介电损耗都小于E玻璃

航空航天导波、印刷电路板、通讯器材、高速数字电子系统

玻璃纤维的生产有"球法坩埚拉丝"、"池窑法直接拉丝"两种工艺。坩埚法采用废旧碎玻璃融成玻璃球，再通过电加热融化拉丝，能耗高、产品品质差。池窑法直接拉丝将叶蜡石等磨细入窑，加热熔化物料后直接拉丝，产量大、质量稳、能耗低，是目前最先进的工艺方法。玻纤拉丝后再经过络纱、织布等工序，可形成各类机织物。

池窑拉丝法一直占据主流工艺，同时应用多孔漏板、多合金漏板、无硼配方、纯氧燃烧等，使得玻纤直径得以精确控制，生产能耗不断下降，污染不断降低，玻纤稳定性等品质不断提高。

玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性。其上游原料包括叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等主要矿物原料和硼酸、纯碱等化工原料，而下游应用领域广泛，既包括建材、电子等传统领域，也涉足风电、航天航空，海洋工程等新兴领域。从产业链上看，玻璃纤维行业已形成玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料三大环节，并且环环相扣。

目前，世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，其上游产业涉及采掘、化工、能源，下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。

从全球角度来看，玻纤下游需求主要集中于建筑与交通领域，总占比60%，分别占比

32%和28%。

2019年全球玻璃纤维下游需求结构

5.3.2 中国玻璃纤维面临巨大市场需求

玻纤用途广泛，在建材、石化、汽车、印刷电路板、风电叶片、电子电气、新能源等领域中有大量应用，需求增长与宏观经济具有同步性。2014年以来，随着美国和欧盟经济进一步好转，海外玻纤市场增长趋势明朗，预计2016~2020年全球玻纤需求复合增速在6%左右；而在风电、交通等需求带动下，国内玻纤需求增速更高，预计未来五年的复合增速8~10%。

2014-2018年中国玻璃纤维供需平衡表分析（万吨）

年份	产量	进口	出口	表观消费量
2009年	292.6	19.1	97.7	214.0
2010年	364.1	25.7	121.0	268.8
2011年	372.2	21.1	122.1	271.2
2012年	20.5	122.0	329.5	2013年
	494.9	23.5	120.3	

398.1
2014年
521.3
24.9
132.6
413.6
2019年
592.7
23.8
128.9
487.6

玻璃纤维的主要应用领域首先是航空领域。玻璃纤维另一个应用较多的领域是能源电力。专家介绍，目前火力发电量占全球发电量的一半以上，所有的火力发电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统，而玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）则是这一应用领域内性价比最高的材料。我国玻璃钢在脱硫系统的应用还处于上升阶段，已有少数玻璃钢企业能够提供满足脱硫系统使用要求的玻璃钢制品。在未来20年内，我国燃煤电厂的脱硫容量将增长一倍以上，如果玻璃钢行业采取适当的措施，加强产品开发、设备制造和技术更新，加强市场宣传和拓展，必将为玻璃钢产品在烟气脱硫市场的应用开拓出广阔的市场。

此外，输变电设施也是玻璃纤维的应用市场之一

5.3.3 2018年中国玻璃纤维行业经济运行情况

5.3.4 2018年中国玻璃纤维的发展情况

第六章 PCB下游应用领域分析

6.1 消费类电子产品

6.1.1 2018年中国消费电子产品走向高端

6.1.2 消费电子用PCB的市场需求稳定增长

6.1.3 高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

6.1.4 消费电子行业未来发展市场调查分析

6.2 通讯设备

6.2.1 2018年中国通讯设备制造业发展情况

6.2.2 未来移动通信设备的趋势

6.2.3 语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

6.3 汽车电子

6.3.1 PCB成为汽车电子市场的热点

6.3.2 多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

6.3.3 2018年全球汽车电子PCB市场发展分析

6.4 LED照明

6.4.1 2018年中国LED照明的发展状况

6.4.2 LED发展为PCB行业带来新需求

6.5 电脑及相关产品发展分析

6.5.1 2018年电脑及相关产品市场情况

6.5.2 2018年国内电脑市场需求分析预测

6.6 工业及医疗电子市场发展分析

6.6.1 2018年工业电子市场发展分析

6.6.2 2018年医疗电子市场发展分析

6.6.3 2018年医疗电子市场机遇分析

第七章 PCB市场行为研究

7.1 消费者行为研究

7.1.1 PCB性能表现及认知

在线阅读: <http://www.360Baogao.com/0/27/PCBHangYeQianJingFenXi.html>

7.1.2 消费者主要流向研究

7.1.3 消费者对PCB的品牌认知

7.1.4 消费者对PCB的评价

7.2 PCB终端研究

7.2.1 渠道商推荐品牌

7.2.2 如何打动PCB采购商

第八章 PCB制造技术的研究

8.1 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

8.1.1 PCB芯片封装的介绍

8.1.2 PCB芯片封装的主要焊接方法

8.1.3 PCB芯片封装的流程

8.2 光电PCB技术

8.2.1 光电PCB的概述

8.2.2 光电PCB的光互连结构原理_咨,询,电,话:40,0,6,1,2,8,66,8

8.2.3 光学PCB的优点

8.2.4 光电PCB的发展阶段

8.3 PCB抄板

8.3.1 PCB抄板简介

8.3.2 PCB抄板技术流程

8.3.3 PCB抄板技术价值分析

8.3.4 PCB抄板发展趋势

8.4 PCB技术的发展趋势

8.4.1 沿着高密度互连技术(HDI)道路发展下去

8.4.2 组件埋嵌技术具有强大的生命力

- 8.4.3 PCB中材料开发要更上一层楼
- 8.4.4 光电PCB前景广阔
- 8.4.5 制造工艺要更新、先进设备要引入

第九章 PCB行业竞争格局分析

- 9.1 PCB行业竞争格局概况
 - 9.1.1 区域集中度分析
 - 9.1.2 市场集中度分析
 - 9.1.3 企业集中度分析
- 9.2 PCB行业竞争情况五力分析
 - 9.2.1 同业之间的竞争比较激烈，市场集中度低
 - 9.2.2 目前尚没有能够替代印刷电路板的成熟技术和产品
 - 9.2.3 整机装配厂家增加INHOUSE布局以降低成本
 - 9.2.4 供应商的集中度比较高，议价能力比较强
 - 9.2.5 消费类电子中整机产品价格不断下滑，工业类电子产对PCB的价格不敏感
- 9.3 中国PCB研发力分析
 - 9.3.1 PCB研发重要性分析
 - 9.3.2 中国PCB研发力问题分析
- 9.4 2014-2018年PCB品牌竞争分析
 - 9.4.1 2018年销售前10名PCB品牌
 - 9.4.2 2019-2025年PCB品牌竞争趋势
- 9.5 PCB行业竞争动态分析
 - 9.5.1 PCB厂转移阵地竞争激烈
 - 9.5.2 PCB行业潜在进入者威胁
 - 9.5.3 PCB新技术打破竞争格局
 - 9.5.4 PCB上游原材料竞争动态

第十章 国外重点PCB制造商介绍

- 10.1 日本企业
 - 10.1.1 日本揖斐电株式会社（IBIDEN）
 - 10.1.2 日本旗胜（NIPPONMEKTRON）
 - 10.1.3 日本CMK公司
- 10.2 美国企业
 - 10.2.1 MULTEK
 - 10.2.2 美国TTM
 - 10.2.3 新美亚（SANMINA-SCI）
 - 10.2.4 惠亚集团（VIASYSTEMS）
- 10.3 韩国企业

- 10.3.1 三星电机 (SAMSUNGE-M)
- 10.3.2 永丰 (YOUNGPOONGGROUP)
- 10.3.3 LGELECTRONICS

10.4 台湾企业

- 10.4.1 欣兴电子股份有限公司
- 10.4.2 健鼎科技股份有限公司
- 10.4.3 雅新电子集团

第十一章 国内PCB重点企业发展分析

11.1 PCB企业排名情况

- 11.1.1 PCB企业排名及销售收入情况
- 11.1.2 覆铜箔板企业排名及销售收入情况
- 11.1.3 专用材料企业排名及销售收入情况
- 11.1.4 专用化学品企业排名及销售收入情况
- 11.1.5 专用设备和仪器企业排名及销售收入情况
- 11.1.6 环保洁净企业排名及销售收入情况

11.2 广东生益科技股份有限公司

- 11.2.1 企业概况
- 11.2.2 经营分析
- 11.2.3 财务分析
- 11.2.4 企业动态

11.3 方正科技集团股份有限公司

- 11.3.1 企业概况
- 11.3.2 经营分析

China's PCB industry development status survey and market prospects report from 2019-2025

- 11.3.3 财务分析
- 11.3.4 企业动态

11.4 广东汕头超声电子股份有限公司

- 11.4.1 企业概况
- 11.4.2 经营分析
- 11.4.3 财务分析
- 11.4.4 企业动态

11.5 广东超华科技股份有限公司

- 11.5.1 企业概况
- 11.5.2 经营分析
- 11.5.3 财务分析

11.5.4 企业动态

11.6 天津普林电路股份有限公司

11.6.1 企业概况

11.6.2 经营分析

11.6.3 财务分析

11.6.4 企业动态

11.7 其他重点PCB企业发展分析

11.7.1 瀚宇博德科技（江阴）有限公司

11.7.2 广州添利电子科技有限公司

11.7.3 珠海紫翔电子科技有限公司

11.7.4 沪士电子股份有限公司

11.7.5 南亚电路板（昆山）有限公司

11.7.6 联能科技（深圳）有限公司

11.7.7 名幸电子（广州南沙）有限公司

11.7.8 广州宏仁电子工业有限公司

11.7.9 惠州中京电子科技股份有限公司

11.7.10 深圳市艾诺信射频电路有限公司

11.7.11 常州安泰诺特种印制板有限公司

11.7.12 敬鹏（苏州）电子有限公司

11.7.13 上海埃富匹西电子有限公司

11.7.14 深圳市景旺电子股份有限公司

11.7.15 昆山方正电路板有限公司

11.7.16 广东世运电路科技股份有限公司

11.7.17 嘉联益科技股份有限公司

11.7.18 苏州福莱盈电子有限公司

11.7.19 东莞五株科技

11.7.20 广州杰赛科技股份有限公司

11.7.21 深圳博敏电子股份有限公司

11.7.22 深圳市众嘉鑫电路科技有限公司

11.7.23 泰州市博泰电子有限公司

第十二章 PCB企业竞争策略分析

12.1 PCB市场发展潜力分析

12.1.1 PCB市场增长潜力分析

12.1.2 PCB主要潜力品种分析

12.2 PCB企业市场策略分析

12.2.1 PCB价格策略分析

- 1、决定PCB价格的因素
- 2、PCB定价策略
- 12.2.2 PCB渠道策略分析
- 12.3 PCB企业销售策略分析
 - 12.3.1 产品定位策略分析
 - 12.3.2 促销策略分析
- 12.4 PCB企业经营策略分析

第十三章 PCB行业发展趋势分析

- 13.1 PCB行业发展前景分析
 - 13.1.1 全球PCB行业发展前景分析
 - 13.1.2 中国PCB行业发展前景分析
- 13.2 2019-2025年中国PCB发展趋势分析
 - 13.2.1 2019-2025年PCB政策趋向
 - 1、PCB政策趋向
 - 2、PCB十三五规划项目重点
 - 13.2.2 2019-2025年PCB技术革新趋势
 - 13.2.3 2019-2025年PCB价格走势分析
 - 13.2.4 2019-2025年PCB产品趋势分析
 - 13.2.5 2019-2025年PCB营销趋势分析

13.3 2019-2025年中国PCB市场趋势分析

- 13.3.1 2019-2025年中国PCB市场发展趋势
- 2019-2025 nián zhōngguó PCB háng yè fā zhǎn xiàng zhù àng dì yóu yǔ

shì chǎng qián jǐng yù cè bàogào

- 13.3.2 2019-2025年中国PCB市场发展空间

13.4 未来PCB行业全球发展动向

- 13.4.1 韩国PCB业高速发展
- 13.4.2 最新版PCB技术推出

第十四章 未来PCB行业发展预测

- 14.1 2019-2025年全球PCB市场预测
 - 14.1.1 2019-2025年全球PCB行业产值预测
 - 14.1.2 2019-2025年全球PCB市场需求预测
- 14.2 2019-2025年中国PCB市场预测
 - 14.2.1 2019-2025年中国PCB行业产值预测
 - 14.2.2 2019-2025年中国PCB市场需求预测

第十五章 PCB行业投资环境分析

- 15.1 政策环境对行业发展的影响分析
 - 15.1.1 人民币升值
 - 15.1.2 新企业所得税法
 - 15.1.3 环保问题与ROHS标准
 - 15.1.4 新劳动合同法的实施
 - 15.1.5 节能减排对行业发展的影响
- 15.2 中国经济发展环境分析
 - 15.2.1 2018年中国宏观经济运行情况
 - 15.2.2 2018年中国电子信息经济运行分析
 - 15.2.3 2018年中国电子元器件经济运行分析
- 15.3 社会发展环境分析
- 15.4 技术发展环境分析
 - 15.4.1 电镀技术是行业发展的关键
 - 1、PCB电镀工艺发展
 - 2、水平电镀工艺在PCB电镀里的应用
 - 15.4.2 世界PCB技术发展分析
 - 1、印制电路板制造技术发展
 - 2、印制电路板在关键工艺技术发展趋势
 - 3、印制电路板检测技术发展分析

第十六章 PCB行业投资机会与风险

- 16.1 PCB行业关联度
 - 16.1.1 集成电路离不开印制板
 - 16.1.2 高新技术产品少不了印制板
 - 16.1.3 现代科学和管理体现在印制板
 - 16.1.4 当代电子元件业中最活跃的
- 16.2 PCB行业投资SWOT分析
 - 16.2.1 优势
 - 16.2.2 劣势
 - 16.2.3 机会
 - 16.2.4 威胁
- 16.3 行业进入壁垒
 - 16.3.1 资金壁垒
 - 16.3.2 技术壁垒
 - 16.3.3 环保壁垒
 - 16.3.4 客户认可壁垒
- 16.4 投资风险分析

16.4.1 经营环境日趋严峻

16.4.2 三高问题难以解决

16.4.3 新厂选址问题分析

16.5 小批量PCB行业发展影响因素分析

16.5.1 有利因素

16.5.2 不利因素

第十七章 PCB行业投资现状与建议

17.1 PCB行业投资现状

17.1.1 投资规模情况

17.1.2 投资区域情况

17.2 PCB行业投资建议

17.2.1 PCB投资时机选择

17.2.2 PCB产品结构选择

17.2.3 PCB投资区域选择

17.2.4 PCB投资发展建议

第十八章 济‘研’咨‘询’:PCB行业投资战略研究

18.1 PCB行业经营模式发展分析

18.1.1 生产模式

18.1.2 销售模式

18.1.3 采购模式

18.2 对中国PCB品牌的战略思考

18.2.1 PCB企业实施品牌战略的意义

18.2.2 品牌战略在企业发展中的重要性

18.2.3 PCB企业品牌的现状分析

18.2.4 中国PCB企业品牌战略

18.3 民营PCB企业的发展与思考

18.3.1 企业应审视经营环境明确经营战略

18.3.2 管理制度的导向作用对发展的影响

18.3.3 认识资本运作魅力与企业发展规律

18.3.4 重视企业文化及放权与监督制度化

18.4 PCB行业投资战略研究

18.4.1 成本战略研究

18.4.2 技术创新战略

18.4.3 规范战略

18.4.4 信息化发展战略

18.4.5 人才整合战略

略……

订购《2019-2025年中国PCB行业发展现状调研与市场前景预测报告》，报告编号：2356270，

请拨打：400 612 8668、010-66181099、010-66182099

Email: kf@360baogao.com，传真：010-66183099

在线阅读：<http://www.360Baogao.com/0/27/PCBHangYeQianJingFenXi.html>

相关报告

- ※ 2019-2025年中国pcb耗材市场调研及发展前景分析报告
- ※ 2019-2025年中国PCB电路板行业发展现状调研与发展趋势分析报告
- ※ 2019-2025年中国PCB电路板市场调查研究及发展趋势分析报告
- ※ 2019-2025年中国印制电路板（PCB）行业研究分析及发展趋势预测报告
- ※ 2019年中国PCB药水行业研究分析报告
- ※ 中国PCB行业现状调研分析及市场前景预测报告（2019版）
- ※ 2019-2025年中国PCB油墨行业调研与发展趋势预测报告
- ※ 2018-2025年全球及中国印刷电路板（PCB）市场现状调研分析及发展趋势报告
- ※ 2018-2025年中国PCB压合板市场现状调研分析及发展前景报告
- ※ 中国车用PCB行业现状调研及未来发展趋势分析报告（2019-2025）
- ※ 2019-2025年中国壁挂机发展现状调研及未来走势预测报告
- ※ 中国装饰金融行业回顾与发展趋势分析报告（2019-2025年）
- ※ 2019-2025年中国隐形纱窗市场深度调查分析及发展前景研究报告
- ※ 中国滑轨行业现状研究及趋势预测分析报告（2019-2025年）
- ※ 2019-2025年中国透光立体玻璃行业现状研究分析及发展趋势预测报告
- ※ 中国铝塑板行业调查分析及市场前景预测报告（2019-2025年）
- ※ 中国OLED行业现状调研及未来发展趋势分析报告（2019-2025）
- ※ 中国陶瓷纤维毡市场调查分析及投资机会研究报告（2019-2025年）
- ※ 2019-2025年中国智能马桶市场现状调研分析及发展趋势报告
- ※ 2019-2025年中国隔音窗帘行业现状分析与发展前景研究报告

在线阅读：<http://www.360Baogao.com/0/27/PCBHangYeQianJingFenXi.html>